

合肥晶合集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕954号）。《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次初始公开发行股票数量为 501,533,789 股，发行股份占公司发行后总股本的比例为 25.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 576,763,789 股，约占公司发行后总股本的比例为 27.71%
本次发行价格（元/股）	人民币 19.86 元
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员及核心员工通过“中金丰众 42 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”“中金丰众 43 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”“中金丰众 44 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”“中金丰众 45 号员工参与科创板战略配售集

	合资产管理计划”参与本次公开发行的战略配售。前述资管计划合计认购金额不超过 402,928,925.95 元，且配售数量不超过首次公开发行股票数量的 10%。根据每股 19.86 元的发行价格，前述资管计划共获配 20,288,464 股，合计获配金额为 402,928,895.04 元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司中国中金财富证券有限公司将参与本次发行战略配售，获配的股份数量为本次公开发行股票数量的 2.00%，即 10,030,676 股，获配金额为 199,209,225.36 元。保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
发行前每股收益	1.91 元（以 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	1.43 元（行使超额配售选择权之前） 1.38 元（全额行使超额配售选择权之后） （以 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	13.84 倍（行使超额配售选择权之前） 14.36 倍（全额行使超额配售选择权之后） （每股收益按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	1.74 倍（行使超额配售选择权之前） 1.70 倍（全额行使超额配售选择权之后） （每股净资产按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	8.72 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	11.39 元（行使超额配售选择权之前） 11.68 元（全额行使超额配售选择权之后） （按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	996,046.10 万元（行使超额配售选择权之前） 1,145,452.88 万元（全额行使超额配售选择权之后）
发行费用（不含税）	23,694.46 万元（行使超额配售选择权之前） 26,691.37 万元（全额行使超额配售选择权之后）
发行人和保荐人（主承销商）	

发行人	合肥晶合集成电路股份有限公司		
联系人	朱才伟	联系电话	0551-62637000
保荐人（主承销商）	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620567

发行人：合肥晶合集成电路股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2023年4月26日

（此页无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

发行人：合肥晶合集成电路股份有限公司



2023年4月26日

（此页无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

